

# 東京応化工業株式会社 決算説明会資料

-2019年12月期決算-

2020年2月14日

東京応化工業株式会社

**tok**

© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

## 目次

---

- |                    |      |
|--------------------|------|
| 1. 2019年12月期業績     | p.2  |
| 2. 2020年12月期業績予想   | p.13 |
| 3. tok中期計画2021の取組み | p.21 |

**tok**

© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

# 2019年12月期業績

tok

© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

## 業績概要

03

(百万円、%)

	2018/12	2019/12	
		増減	増減率
売上高	105,277	102,820	△2,457 △2.3
営業利益	10,505	9,546	△959 △9.1
経常利益	10,734	9,707	△1,027 △9.6
親会社株主に 帰属する当期純利益	6,875	5,410	△1,465 △21.3

■ 期中平均為替 (USドル) : 109.5円/ドル (2018/12) ⇒108.1円/ドル (2019/12)

■ 売上高 : 米中通商摩擦の影響等による半導体需要の鈍化に加え、  
米国会計基準改正の影響<sup>(注)</sup>等から前年比△2.3%減収。

■ 営業利益 : 売上減少の影響等から、前年比△9.1%減益。

■ 当期純利益 : 特別損失と非支配株主に帰属する当期純利益増加の影響から、  
前年比△21.3%減益。

(注) 米国会計基準を採用している在外連結子会社において、当連結会計年度よりASC第606号「顧客との契約から生じる収益」を適用しています。

© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

# 営業外損益・特別損益

04

(百万円)

	2018/12	2019/12	増減
営業外損益	228	160	△68
受取利息・配当金	+392	+447	+55
(為替に係る差損益)	(△274)	(△315)	△41
為替差損益	△580	△410	+170
デリバティブ評価損益	+306	+95	△211
特別損益	△920	△1,049	△129
固定資産売却益	+5	+119	+114
減損損失	△860	△477	+383
固定資産除去損	△124	△127	△3
出資金評価損	0	△540	△540

tok

© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

# 事業別セグメントの業績

05

(百万円、%)

	2018/12	2019/12	
		増減	増減率
売上高	105,277	102,820	△2,457 △2.3
材料事業	102,621	98,986	△3,635 △3.5
IL外ロックス機能材料	58,793	58,249	△544 △0.9
高純度化学薬品	43,733	40,674	△3,059 △7.0
その他	95	63	△32 △33.3
装置事業	2,655	3,833	+1,178 +44.4
営業利益	10,505	9,546	△959 △9.1
材料事業	14,765	13,462	△1,303 △8.8
装置事業	△883	△286	+597 -
消去又は全社	△3,376	△3,628	△252 -

(注1) 2019年12月期第1四半期より、報告セグメント別の業績をより適切に評価管理するため、費用の配賦方法を変更し、全社費用の一部を材料事業へ配賦しています。これに伴い、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しています。

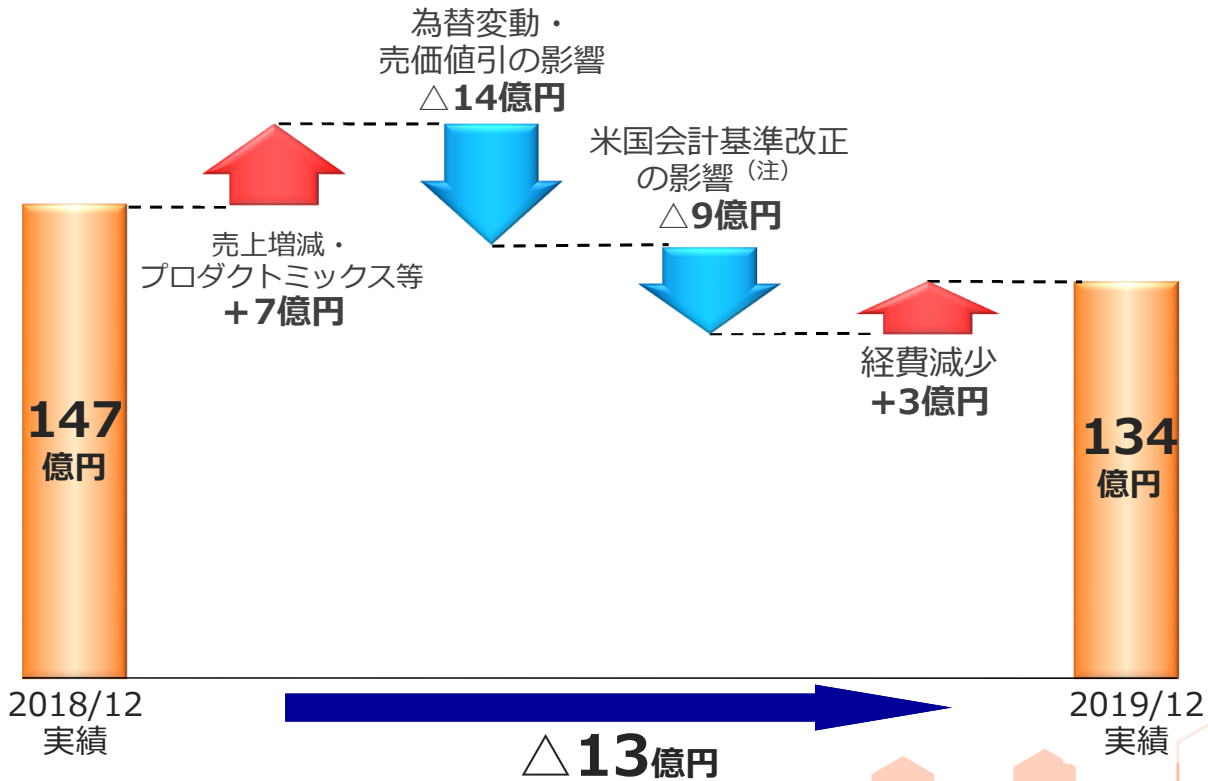
(注2) 米国会計基準を採用している在外連結子会社において、当連結会計年度よりASC第606号「顧客との契約から生じる収益」を適用しています。

tok

© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

# 営業利益の増減内訳（材料事業）

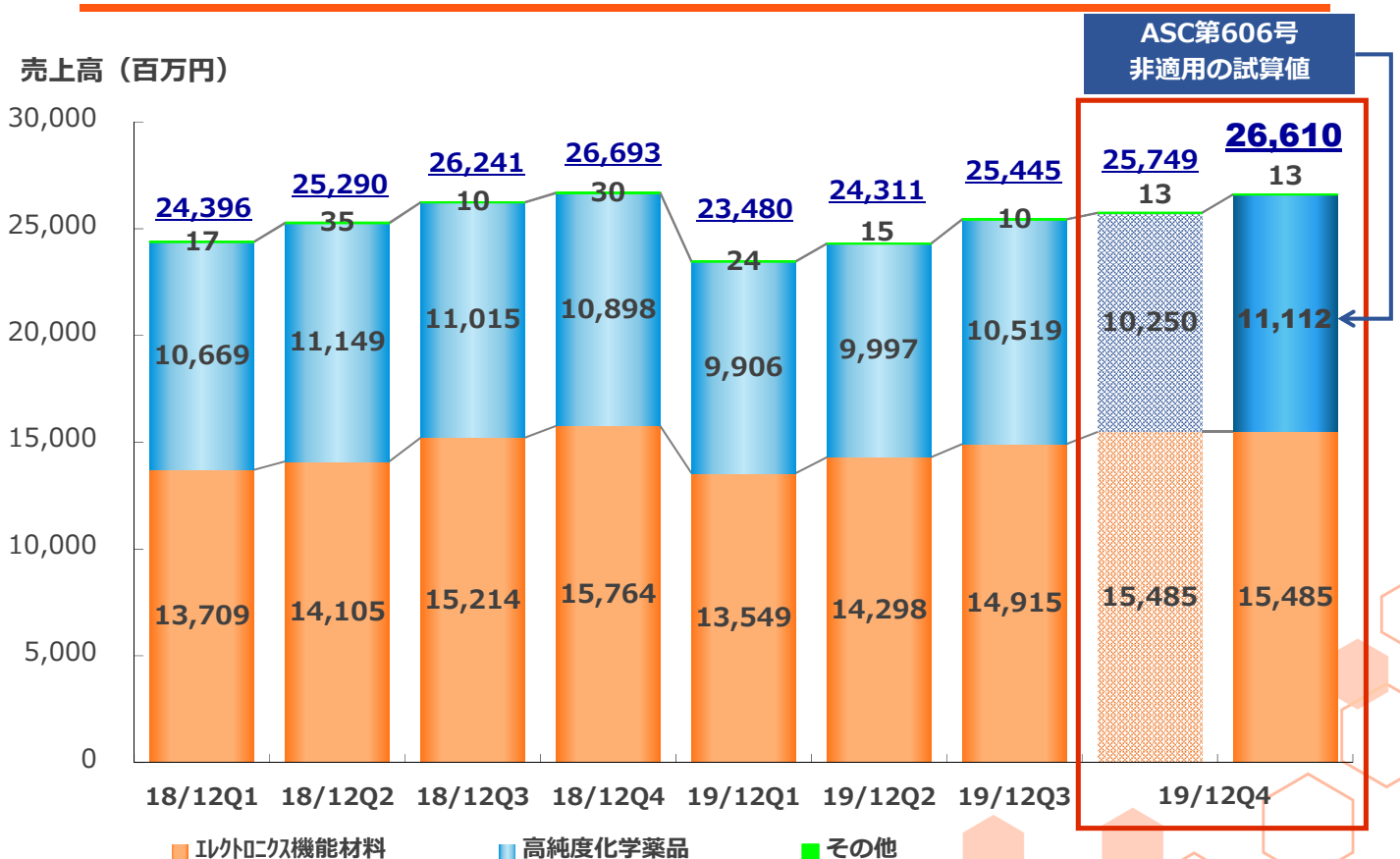
## 2018年12月期実績 対 2019年12月期実績



(注) 米国会計基準改正の影響：米国会計基準を採用している在外連結子会社における、当連結会計年度よりASC第606号「顧客との契約から生じる収益」の適用による影響。



# 材料事業の売上内訳（部門別）

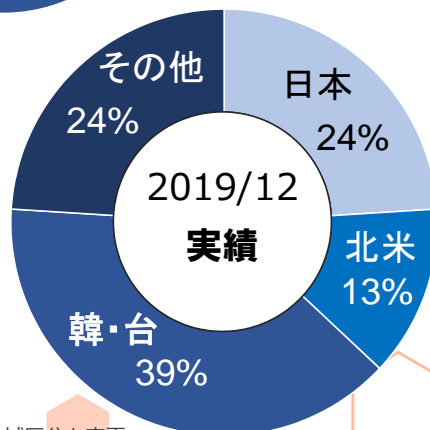
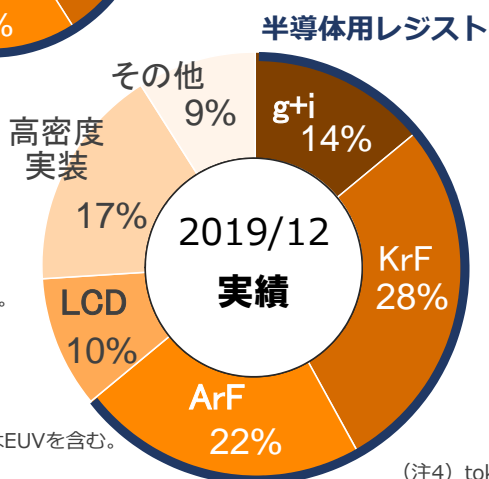
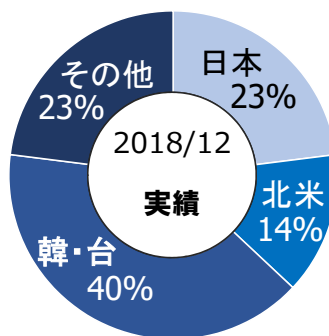
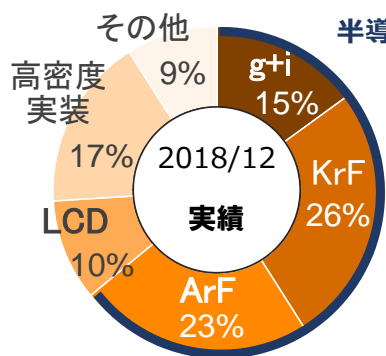


(注) 米国会計基準を採用している在外連結子会社において、当連結会計年度よりASC第606号「顧客との契約から生じる収益」を適用、2019/12期第4四半期の売上高は、同基準の影響を受けています。



## エレクトロニクス機能材料の種類別売上構成

## 半導体用レジストの地域別売上構成



- (注1) EUVはその他に区分。
- (注2) 高密度実装：パッケージ材料、MEMS材料。
- (注3) 半導体用レジストの地域別売上構成にはEUVを含む。

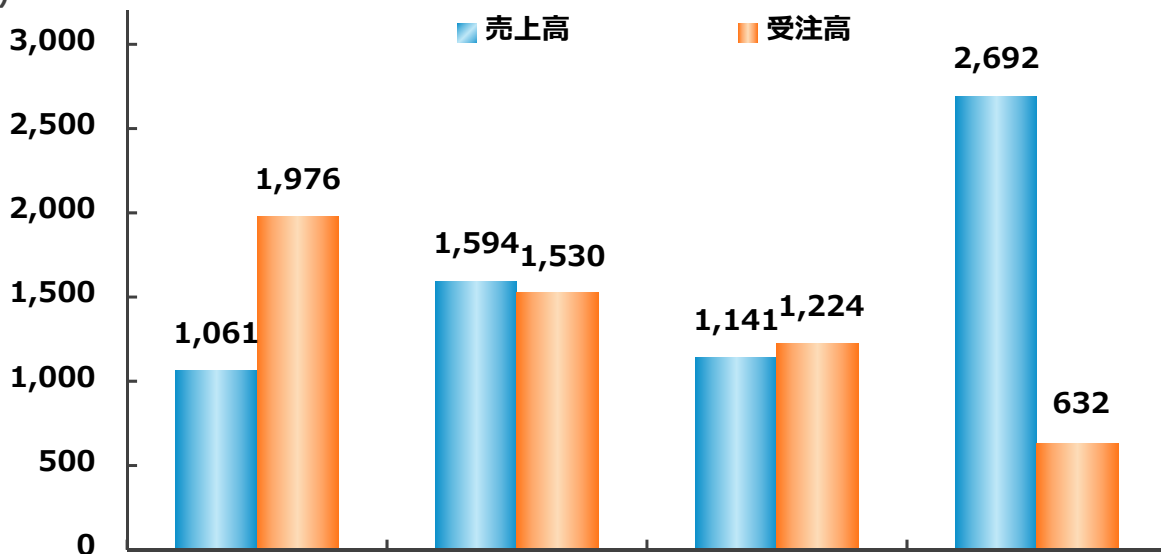
- (注4) tok中期計画2021より地域区分を変更。その他は、欧州及び中国を含む韓国・台湾以外のアジアからの構成。



© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

# 装置事業

売上高・受注高  
(百万円)



(百万円)	18/12上期	18/12下期	19/12上期	19/12下期
期末受注残高	2,291	2,472	2,757	934



© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

(百万円、%)

	2018/12	2019/12	
		増減	増減率
設備投資	5,636	14,183	+8,547 +151.6
減価償却費	7,063	7,216	+153 +2.2
研究開発費	8,526	8,879	+353 +4.1

© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

## 比較貸借対照表

11

(百万円)

	2019/12	18/12末比	
流動資産	93,282	△6,619	
現金預金	46,405	△9,687	
売上債権	23,887	+1,347	
たな卸資産	17,439	+194	
有形固定資産	55,057	+6,698	建物及び構築物 +6,198 機械装置運搬具 △2,748 工具器具備品 △308 土地 △116 建設仮勘定 +3,225
無形固定資産	661	+103	
投資その他の資産	37,485	+3,346	
流動負債	20,316	△1,059	
買入債務	10,345	△1,036	
固定負債	14,437	+3,713	長期借入金 +1,272
純資産合計	151,733	+875	利益剰余金 +23 自己株式 △1,153 その他有価証券評価差額金 +1,380 為替換算調整勘定 △271
総資産	186,486	+3,529	

(注) 米国会計基準を採用している在外連結子会社において、当連結会計年度よりASC第606号「顧客との契約から生じる収益」を適用しています。

© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

(百万円)

	2018/12	2019/12
営業キャッシュフロー	+14,311	+12,743
税金等調整前当期純利益	+9,814	+8,657
減価償却費	+7,063	+7,216
売上債権の増減額(△は増加)	△420	△1,367
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,770	△388
仕入債務の増減額(△は減少)	+1,092	△943
前受金の増減額(△は減少)	△147	△37
法人税等支払額又は還付額(△は支払)	△2,221	△2,302
投資キャッシュフロー	△8,013	△17,286
財務キャッシュフロー	+4,333	△5,789
換算差額	△741	△289
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	+9,889	△10,621

主な内訳  
有形固定資産の取得 △14,774

主な内訳  
長期借入れによる収入 +1,372  
自己株式の取得 △1,371  
配当金の支払 △5,759  
(含む非支配株主)



© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

## 2020年12月期業績予想



© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

# 業績予想概要 (通期)

14

(百万円、%)

	2019/12	2020/12予想	
		増減	増減率
売上高	102,820	107,000	+4,180 +4.1
営業利益	9,546	11,300	+1,754 +18.4
経常利益	9,707	11,700	+1,993 +20.5
親会社株主に 帰属する当期純利益	5,410	7,900	+2,490 +46.0

- 期中平均為替 (USドル) : 108.1 円/ドル (2019/12) ⇒ 105.0円/ドル (2020/12)
- 売上高 : 半導体生産の回復基調に伴う材料事業の成長ステージへの移行を想定。前年比+4.1%増を予想。
- 営業利益 : 全社費用は増加するが、材料事業の増益等から前年比+18.4%増。
- 当期純利益 : 前期の当期純利益減少の反動等もあって、前年比+46.0%増。

**tok**

© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

# 事業別セグメント業績予想

15

(百万円、%)

	2019/12	2020/12予想	
		増減	増減率
売上高	102,820	107,000	+4,180 +4.1
材料事業	98,986	103,200	+4,214 +4.3
I/O機能材料	58,249	60,400	+2,151 +3.7
高純度化学薬品	40,674	42,700	+2,026 +5.0
装置事業	3,833	3,800	△33 △0.9
営業利益	9,546	11,300	+1,754 +18.4
材料事業	13,462	15,300	+1,838 +13.7
装置事業	△286	△100	+186 -
消去又は全社	△3,628	△3,900	△272 -

**tok**

© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.



(百万円、%)

	2019/12	2020/12予想	
		増減	増減率
設備投資	14,183	5,600	△8,583 △60.5
減価償却費	7,216	7,000	△216 △3.0
研究開発費	8,879	9,500	+621 +7.0

tok

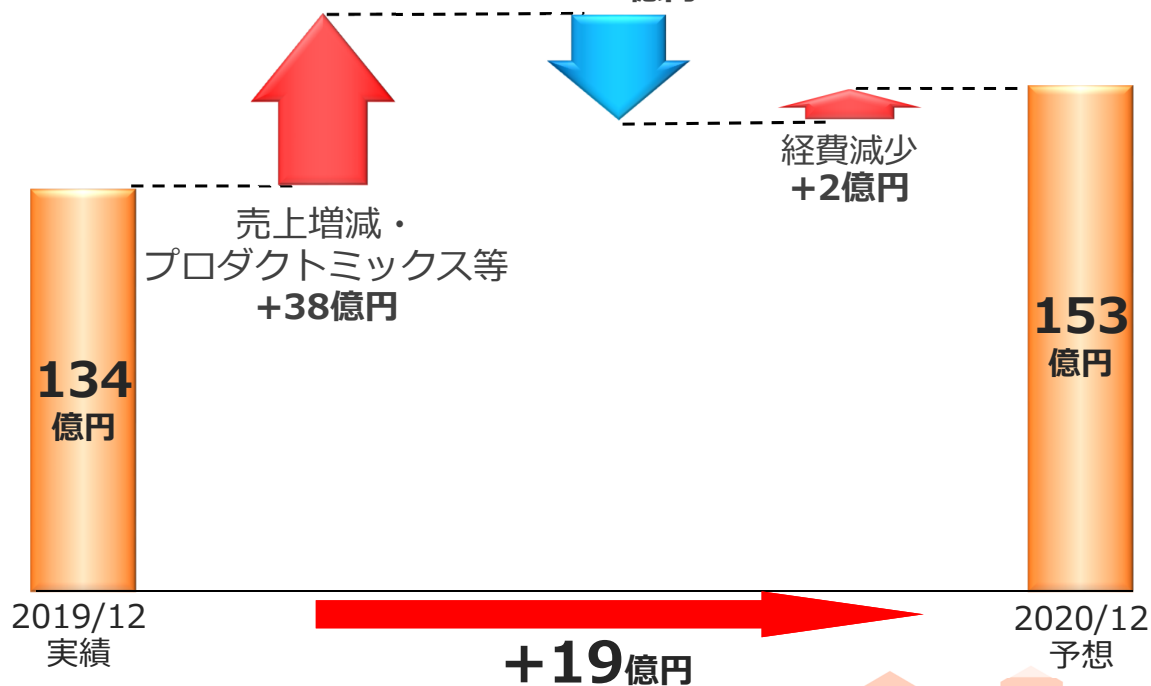
© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

## 営業利益の増減内訳（材料事業）

2019年12月期実績 対 2020年12月期予想

為替変動・売値値引の影響

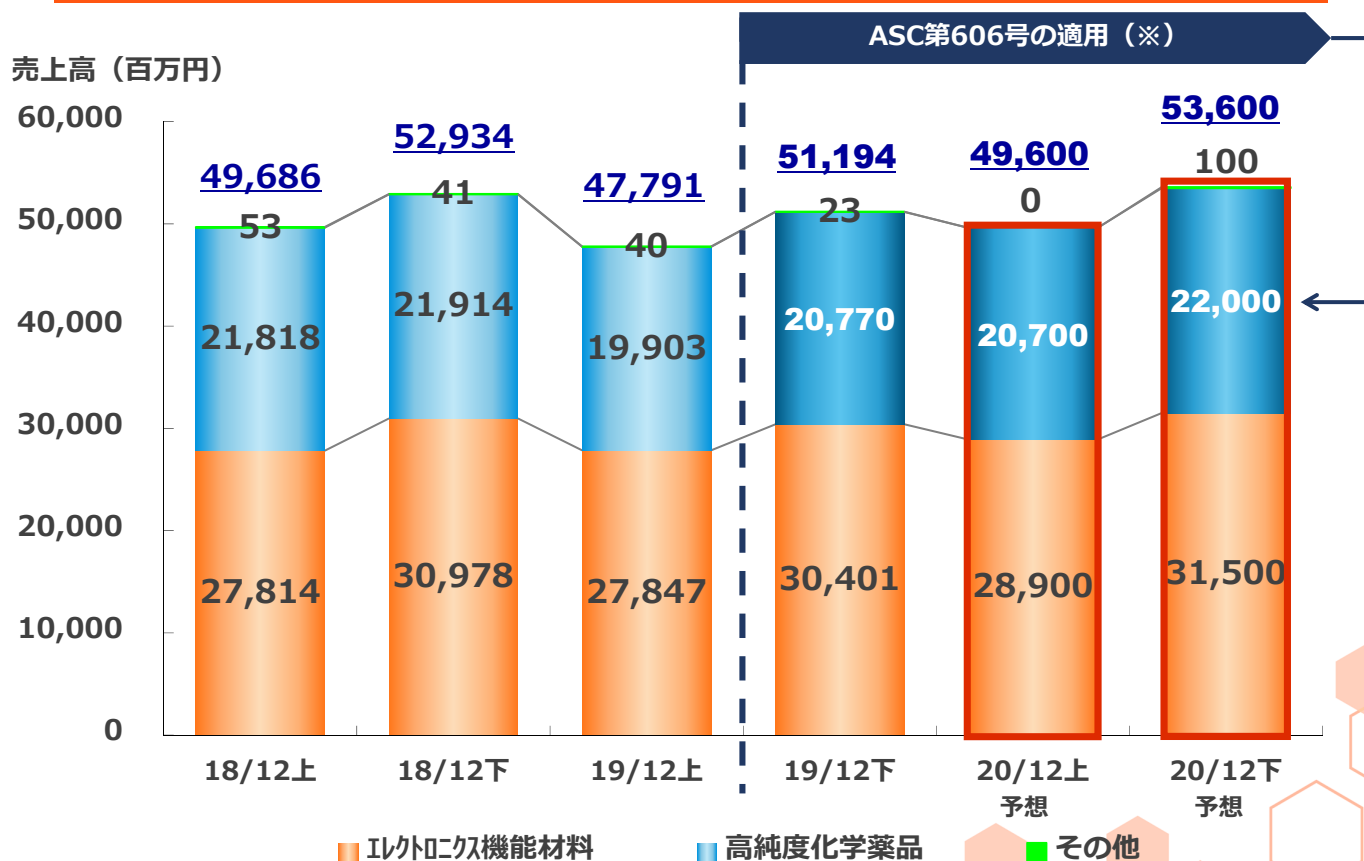
△21億円



tok

© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

# 材料事業の売上予想：部門別



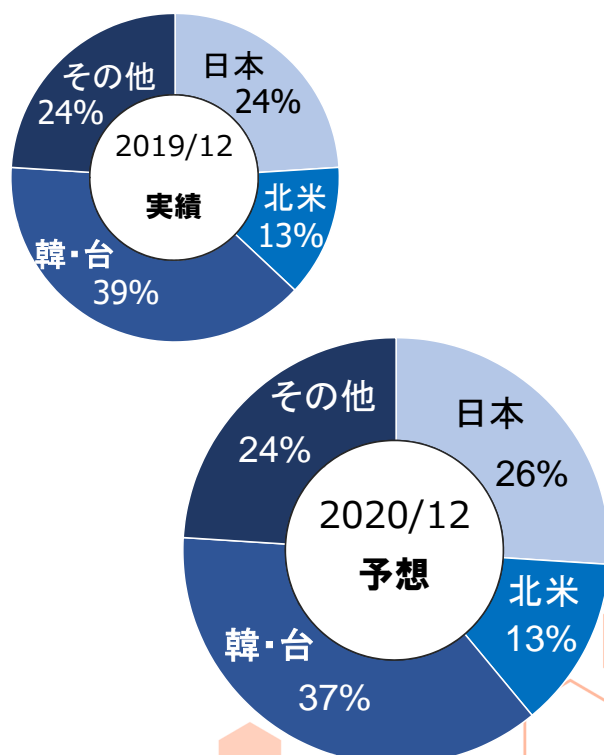
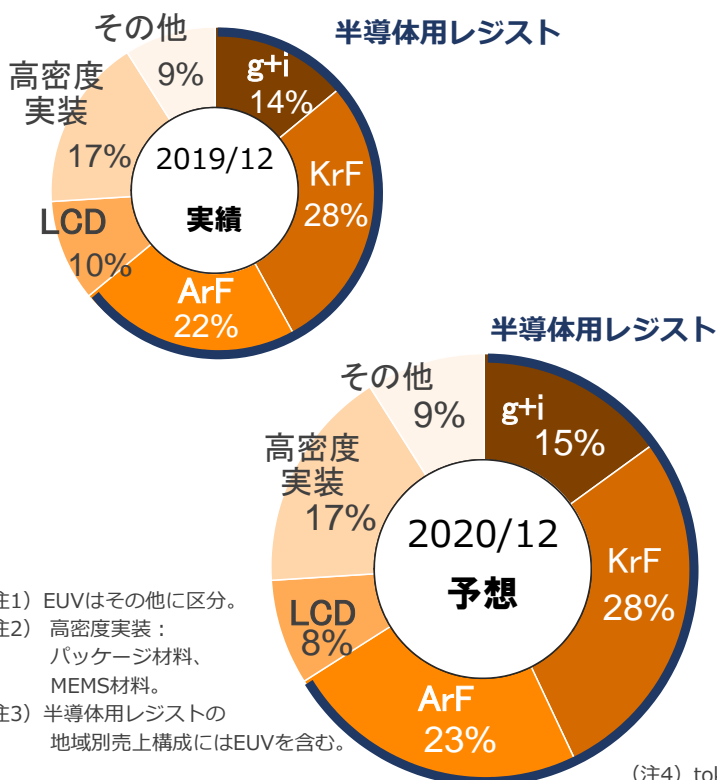
(※) 米国会計基準を採用している在外連結子会社において、ASC第606号「顧客との契約から生じる収益」を適用。



# エレクトロニクス機能材料部門

エレクトロニクス機能材料の種類別売上構成

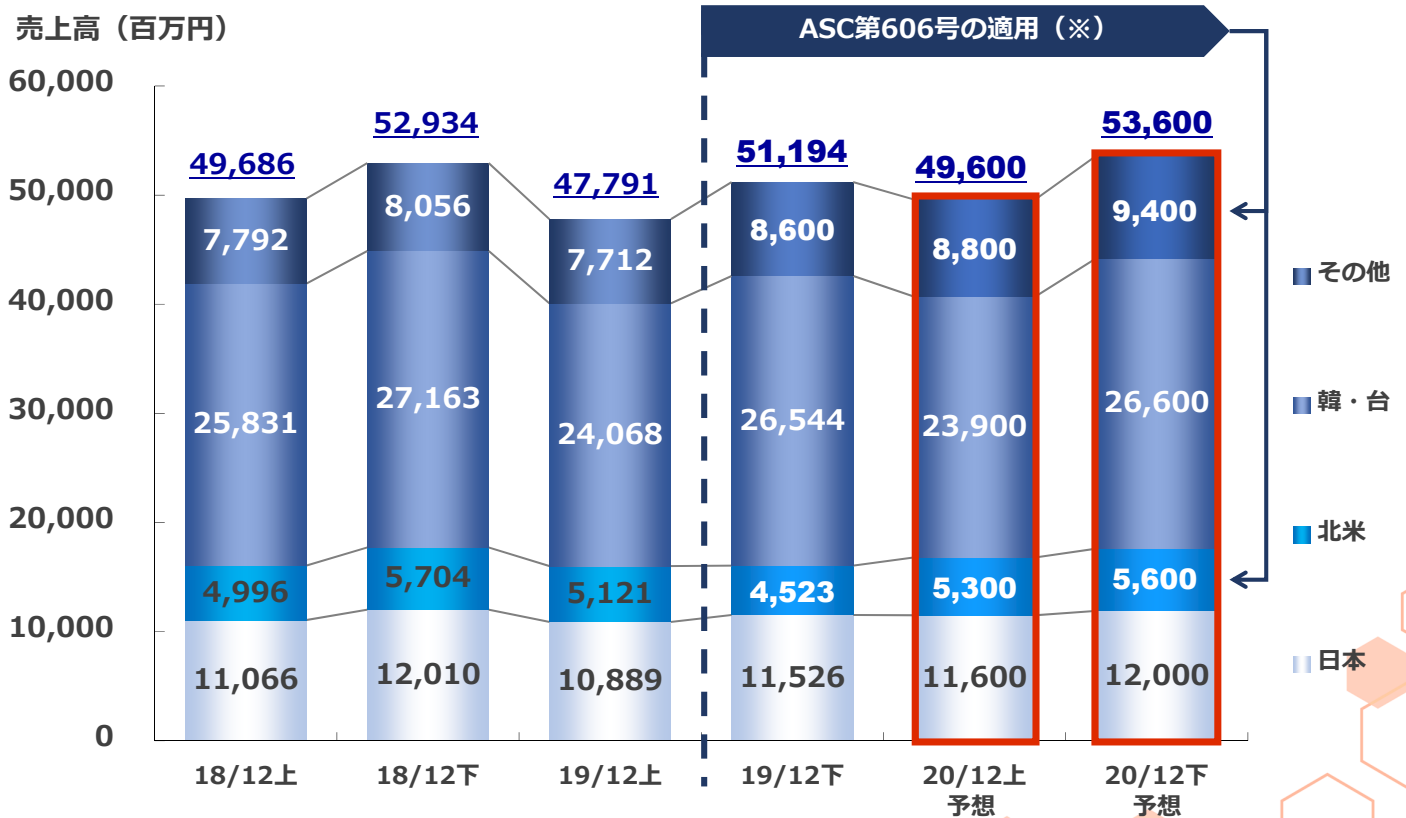
半導体用レジストの地域別売上構成



(注1) EUVはその他に区分。  
 (注2) 高密度実装：パッケージ材料、MEMS材料。  
 (注3) 半導体用レジストの地域別売上構成にはEUVを含む。

(注4) tok中期計画2021より地域区分を変更。  
 その他は、欧州及び中国を含む韓国・台湾以外のアジアからの構成。





(※) 米国会計基準を採用している在外連結子会社において、ASC第606号「顧客との契約から生じる収益」を適用。

(注) その他は、欧州及び中国を含む韓国・台湾以外のアジアからの構成。



© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

## tok中期計画2021の取組み



© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

## 1. 事業ポートフォリオの変革を強化

⇒ 「5G・IoT&Innovation」に求められる技術開発にチャレンジ

## 2. 成長軌道への回帰

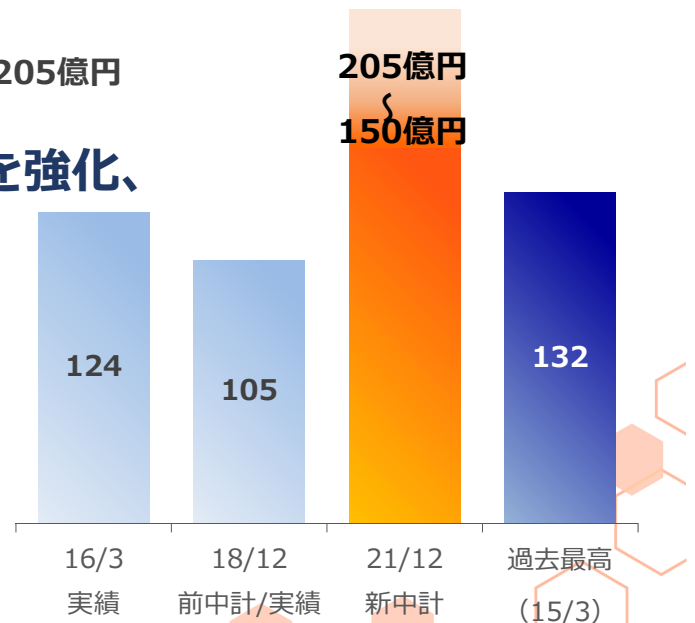
⇒ 営業利益目標 (2021/12期) : 150億円~205億円

## 3. バランスシートマネジメントを強化、 新たな配当方針導入

⇒ DOE3.5%を目処とする新たな配当方針

⇒ 株主還元策として自己株式の取得についても弾力的に対処する

営業利益 (億円)



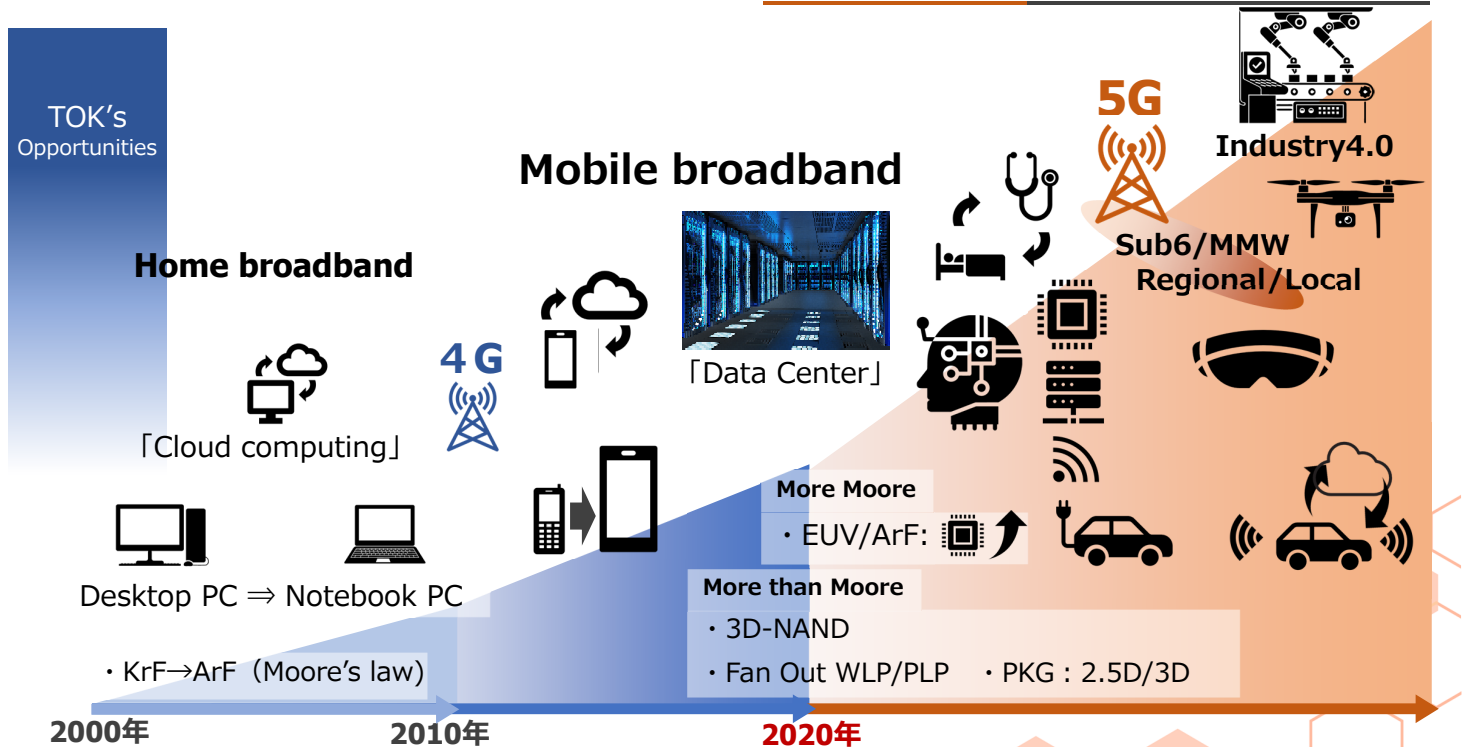
※ 営業利益目標等は中期計画発表時点のものです。最終年度目標の再策定は行っていません。

© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.



# 当社の事業環境認識/ビジネスチャンス

## 5G・IoT&Innovation



© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

## 1. 「5G」：5Gの実用/本格活用に求められる技術対応

- データ処理速度の更なる高速化（高性能チップ）  
⇒EUV/ArF・機能性表面処理剤・先端パッケージ材料
- 高周波対応 ⇒MEMS材料
- センシングデバイスの性能アップ・機能進化  
⇒UVナノインプリント材料（新規事業）

## 2. 「AI」：社会・産業への浸透、求められる進化

- データ処理・データ伝送の高速化  
⇒EUV/ArF・機能性表面処理剤・先端パッケージ材料・3次元実装装置
- ストレージの高容量化 ⇒KrF（厚膜）

## 3. 「Power Management」：半導体市場の裾野拡大

- パワーデバイスの市場拡大・ニーズ拡大  
⇒IGBT基板対応の材料・プラズマアッシング装置

**tok**

© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

# 主要製品の進捗/取組み

### ■ EUV/ArF

※先端レジスト=EUV+ArF

- EUVが先端レジストの売上増加をけん引
- 中国市場向けArFレジストの販売拡大

- EUV  
・ 7nm向け需要の増加  
・ 5nm向けレジストの採用獲得  
・ 3nm向けレジストの採用獲得に注力中
- ArF：中国向けの販売増加

### ■ KrF

- 3D-NANDの生産増加等による  
需要拡大が売上増加をけん引

- 1xx層3D-NAND向け厚膜レジストの採用獲得
- 増産体制の整備・構築

### ■ 高密度実装材料

- 先端パッケージ技術の進展により  
販売拡大を図る

- パッケージ材料：3Dパッケージ向け販売増加
- MEMS材料：  
アジア系電子部品メーカー向け販売増加

### ■ 高純度化学薬品

- アジアに加え、北米が売上増加に  
寄与

- Clean Solution（洗浄液）の生産能力増強
- “機能性表面処理剤”ビジネスの戦略的強化

**tok**

■：中期計画の取組み/目標

© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

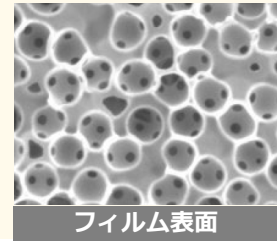
## 高付加価値なリチウムイオン二次電池用セパレータとして採用始まる

### 機能性フィルム



### ポリイミドを用いた多孔質フィルム

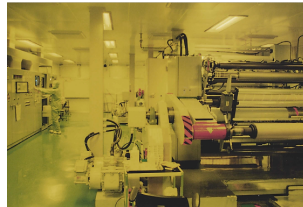
- 高耐熱性
- 高薬品耐性
- 超低誘電率



フィルム表面

### → 高耐久性を実現

1994年：  
厚膜高解像DFR上市



2003年：LCD用スピンスコーター上市

1989年：LCD用大型角基板用  
スピンスコーター開発



1981年：  
プリント基板用DFR開発

1981年：半導体用レジスト用  
スピンスコーター開発

※DFR: ドライフィルムフォトレジストの略

**tok**

© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

# 新規事業②：ライフサイエンス関連材料

## 次世代のDNAシーケンサー向け

### (1) バイオチップの製造用材料

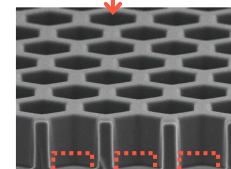
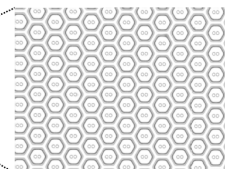
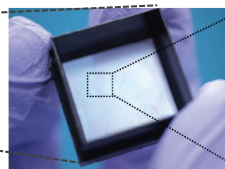
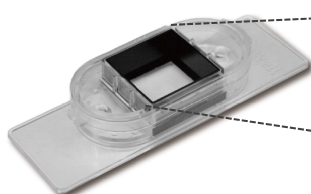
- 高解像、高密着性、高アスペクトのパターン形成可能なMEMS構造形成材料により、マイクロレベルの複雑なデバイス構造の形成技術を提供
- 現行：光学式のDNA解析→ 次世代：電気信号検出形式のDNA解析
- 現行：コスト低減を実現→ 次世代：更なる解析時間の短縮、精度向上に期待

## 患者に負荷の少ない病理診断の研究加速に貢献

### (2) 細胞配列チップ<sup>®</sup> (SIEVEWELL™) を開発、販売開始

- TOKのMEMS構造形成材料により、マイクロウェル構造を形成しキットを提供
- ターゲット細胞の回収、細胞分析に使用

370,000個の細胞ひとつひとつを格納するマイクロウェル



マイクロウェル底部の貫通孔

**tok**

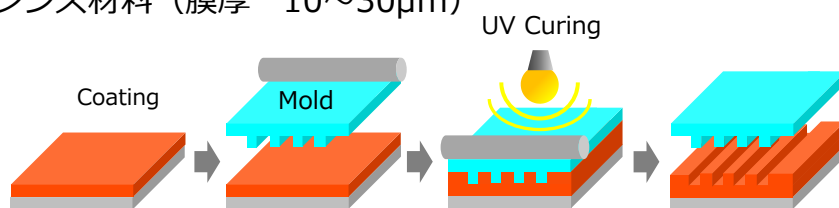
© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.



光をコントロールする材料として

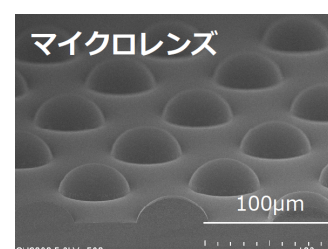
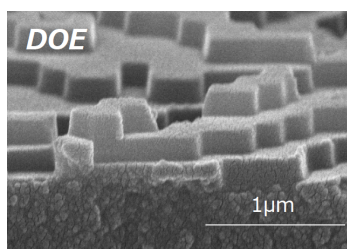
## 光学素子向けUVナノインプリント材料を提供

- AR / VR、3Dセンサー等に使用される光学部材の製造用途
- マイクロレンズ材料（膜厚 10~30 $\mu$ m）



### 特徴

- 屈折率のコントロールが可能
- 高透明性、高耐久性



(注) DOE : Diffractive Optical Element (回折光学素子) の略。微細な凹凸構造によって、照射光を整形。



© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

新技術にチャレンジして、  
技術を磨いて、  
持続可能な地球のために、  
社会の期待に化学で応える

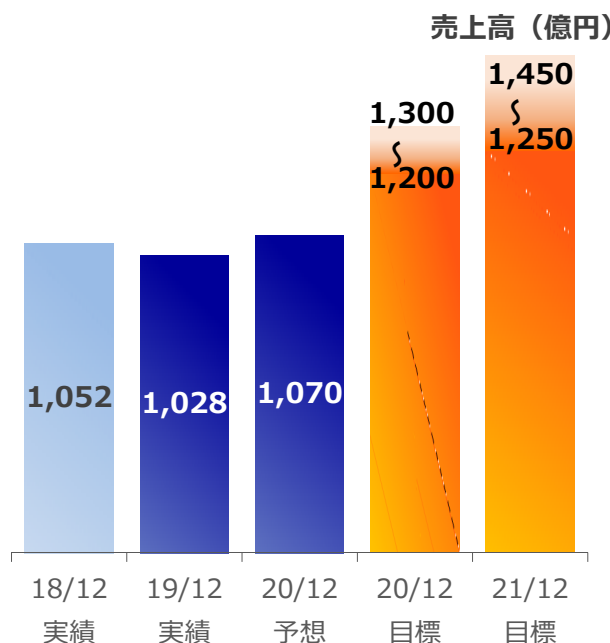
(ご注意)

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがって、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があり、いかなる確約や保証を行うものではありません。

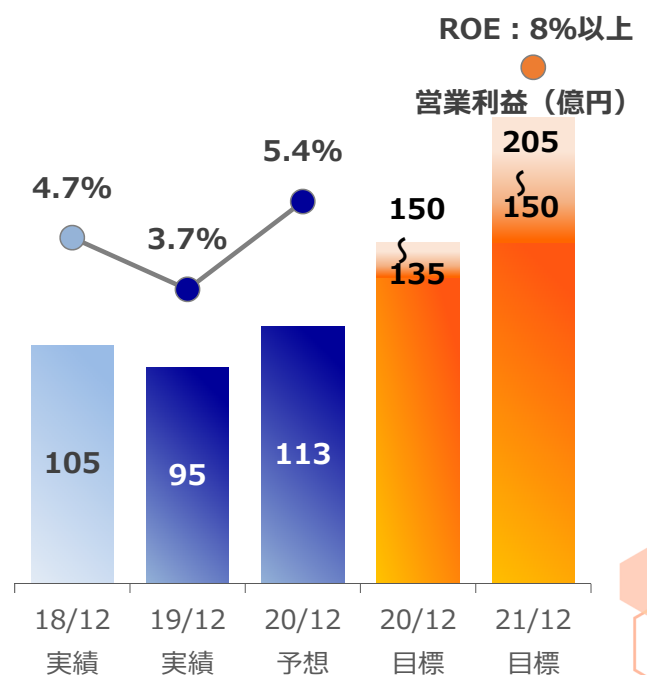


補足①：中計目標値に対する進捗（業績目標） 31

売上高



営業利益/ROE



(注) 20/12目標および21/12目標は、「tok中期計画2021」公表時の数値（公表日：2019年2月14日）。  
20/12予想は、2019年12月期決算公表時の数値（公表日：2020年2月13日）。



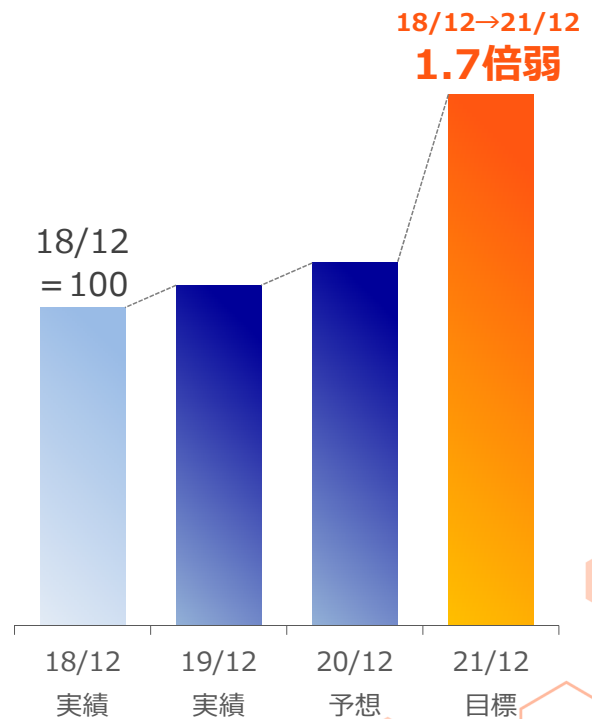


## 先端レジスト（EUV/ArF）

(※) 先端レジスト = EUV + ArF



## KrF

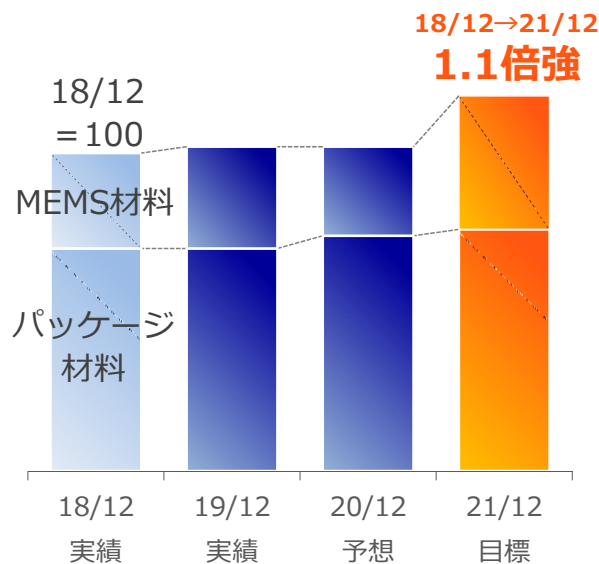


(注) 21/12目標は、「tok中期計画2021」公表時の数値（公表日：2019年2月14日）。  
20/12予想は、2019年12月期決算公表時の数値（公表日：2020年2月13日）。

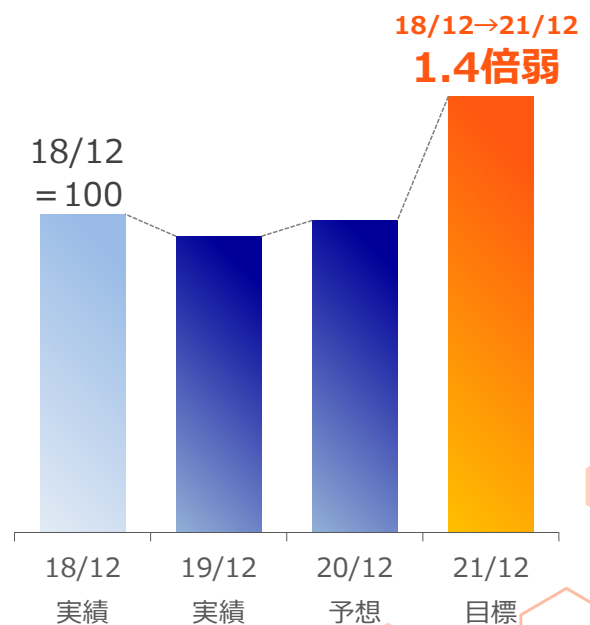


© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

## 高密度実装材料



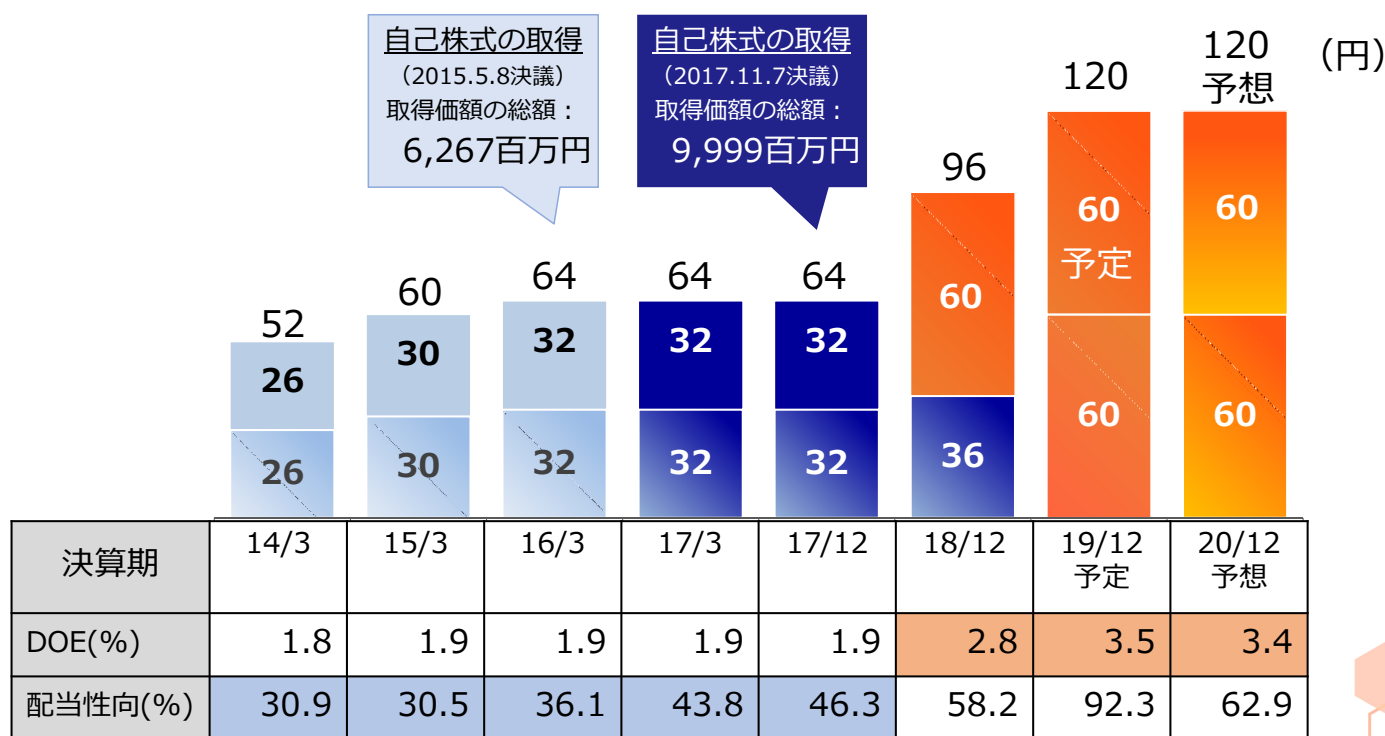
## 高純度化学薬品



(注) 21/12目標は、「tok中期計画2021」公表時の数値（公表日：2019年2月14日）。  
20/12予想は、2019年12月期決算公表時の数値（公表日：2020年2月13日）。



© 2020 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.



配当政策 数値基準

- tok中期計画2015 ~連結配当性向30%以上~
- tok中期計画2018 ~連結配当性向40%以上~
- tok中期計画2021 ~連結DOE3.5%を基準~



# 補足④：マテリアリティの策定

マテリアリティに関連するSDGsの目標達成への貢献も目指すことで、持続的な企業価値向上と、社会との共有価値の創造に邁進

